

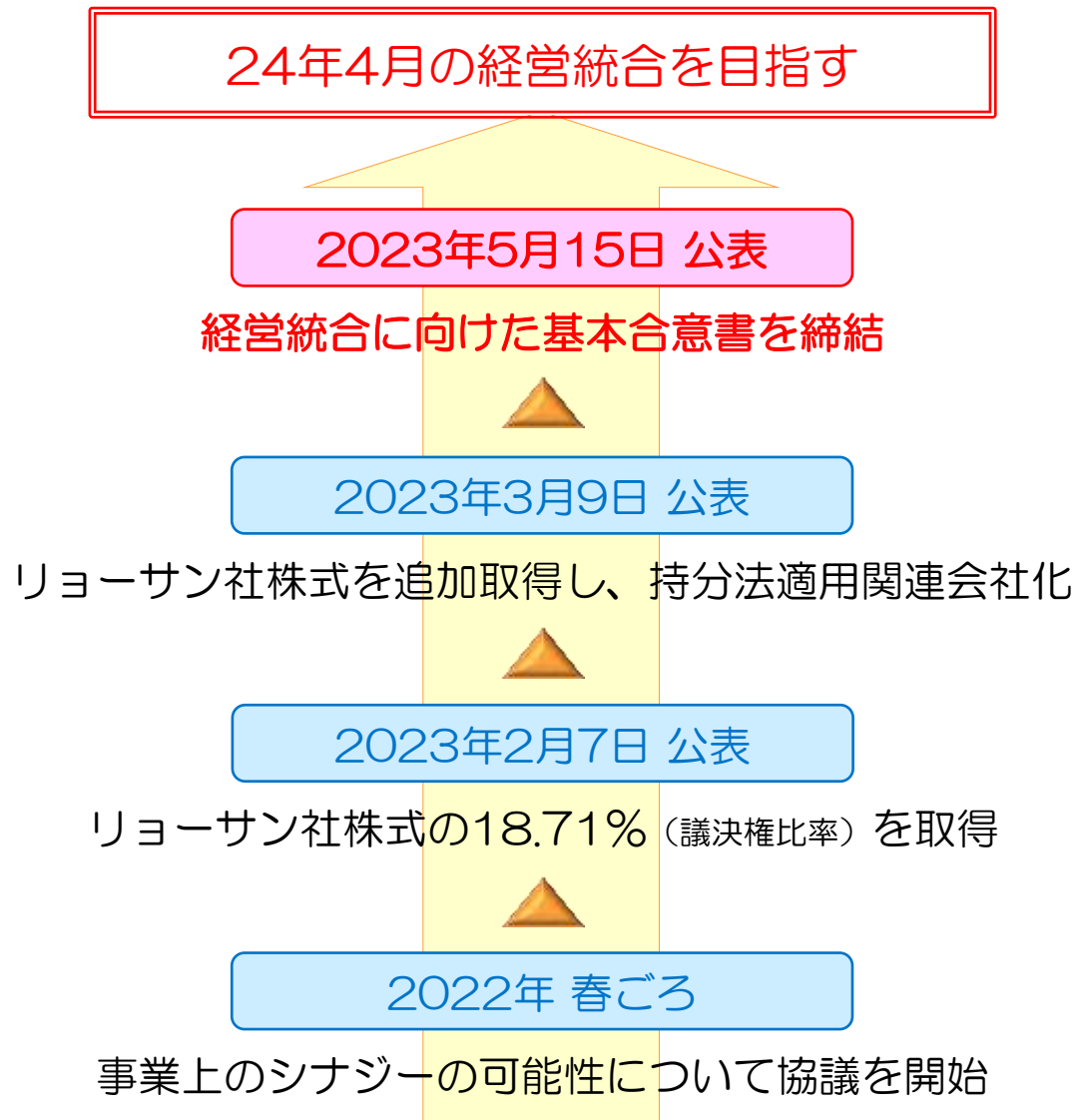
2024年1月期 第1四半期 決算補足資料

2023年5月31日
菱洋エレクトロ株式会社

【東証プライム 証券コード：8068】

<https://www.ryoyo.co.jp>

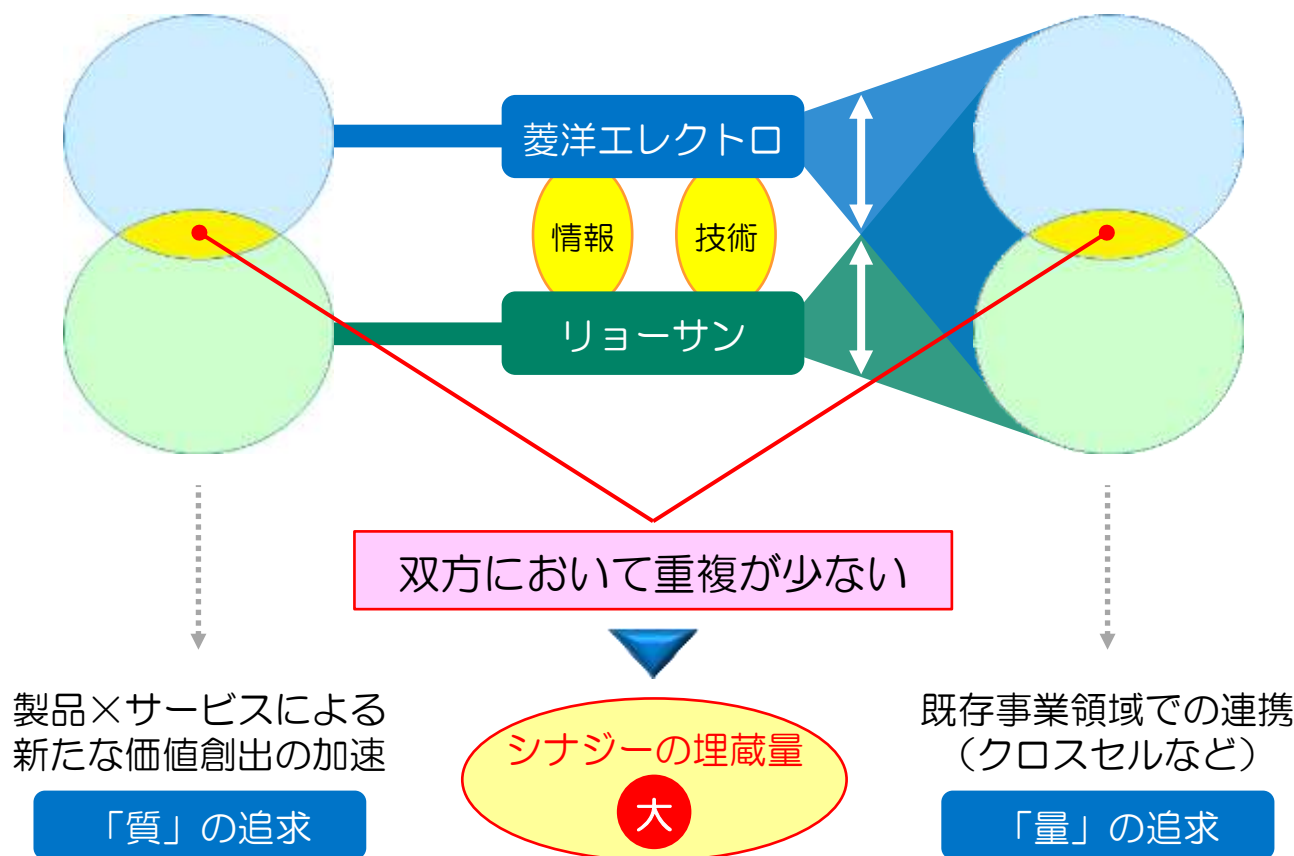
経営統合に向けた基本合意について



お客様との優良なリレーションや商材・ソリューションなど、
両社の有する各種経営資源を最大限に生かした取り組みを推進

【事業構造 / 取扱商材】

【お客様層】



2024年1月期 第1四半期の概況

24.1期の見通し

半導体好市況の
反 動

為替変動による
差益の縮小

大口ビジネスの
終 息

外的要因の変化に当社固有の要因も加わり、厳しい事業環境を想定

これまでの改革および各種施策の成果を示す1年

半導体・デバイス

- ◎ 新規商材、新商権の寄与
(通信、パワー、表示デバイス、センサーなど)
- ◎ 海外ビジネスの深耕

ICT・ソリューション

- ◎ サービス事業の更なる強化
- ◎ 医療分野へのフォーカス
(ものづくり～キitting・機器設置までサポート)

半導体・ICT・サービスが循環したビジネスモデルの推進

“ラストワンマイル”を埋める独自ソリューションの創出
(音声認識、IoTプラットフォームなど)

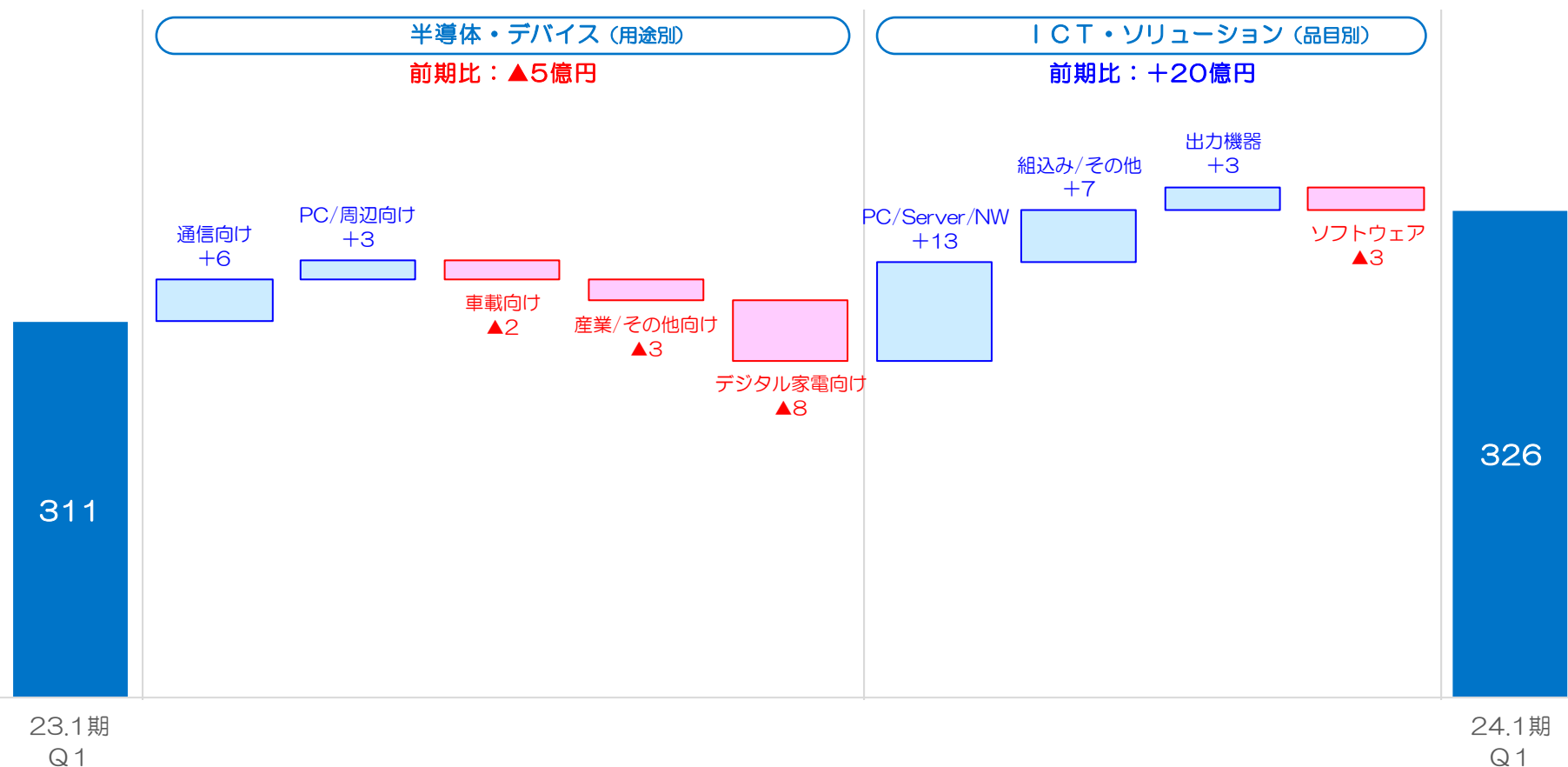
リョーサン社との事業シナジーの追求

当初厳しい事業環境を想定する中、Q1については増収増益で着地

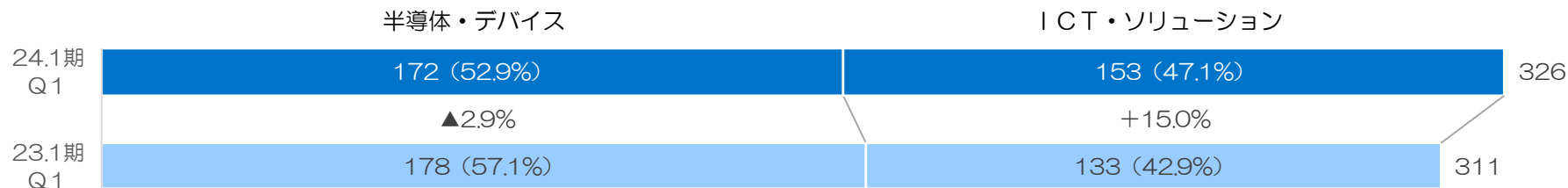
- ◎ ICT関連の伸長を主要因に、売上拡大に加えて、売上総利益率も改善。
- ◎ 負ののれん発生益（42.1億円）を営業外収益として計上したことにより、経常利益および親会社株主に帰属する四半期純利益は増益幅が拡大。

(単位：億円)	23.1期 Q1 (実績)	24.1期 Q1 (実績)	対 前年同期	
			増減額	増減率
売上高	311	326	+15	+4.8%
売上総利益 (率)	32.8 10.6%	36.2 11.1%	+3.4	+10.4%
販管費	21.2	24.3	+3.1	+14.5%
営業利益 (率)	11.6 3.7%	12.0 3.7%	+0.3	+2.9%
経常利益	11.3	52.5	+41.2	+364.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	8.3	49.2	+40.9	+493.9%

- ◎ 半導体・デバイス関連は、テレビ向けの減少や前期の反動が一部見られるも、通信機器・OA機器向けの拡大により、小幅減に留まる。
- ◎ ICT・ソリューション関連は、オンライン資格確認関連の需要取込みもあり、引き続き堅調に推移。



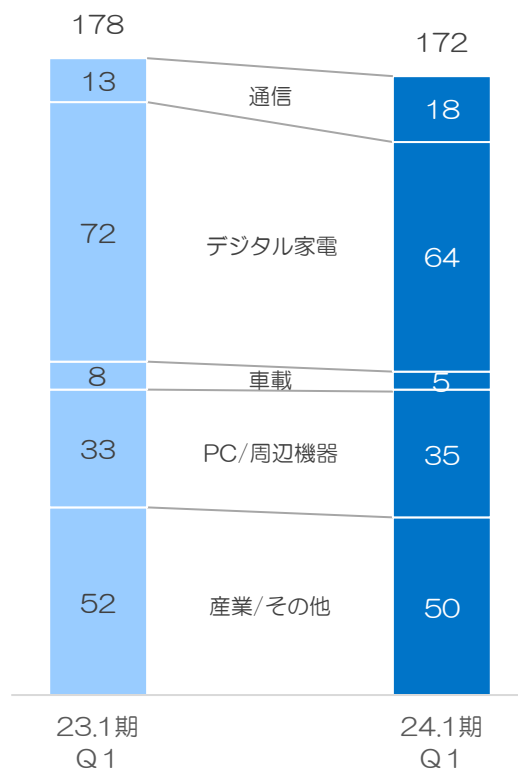
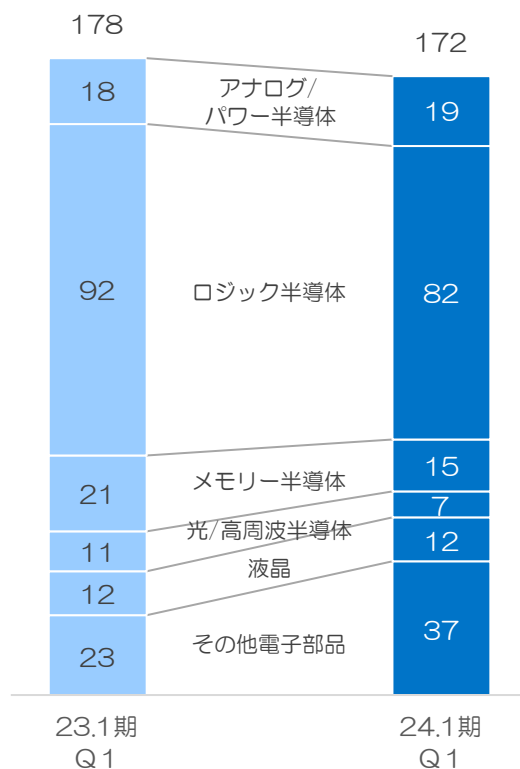
<補 足> 品目別の状況



半導体・デバイス

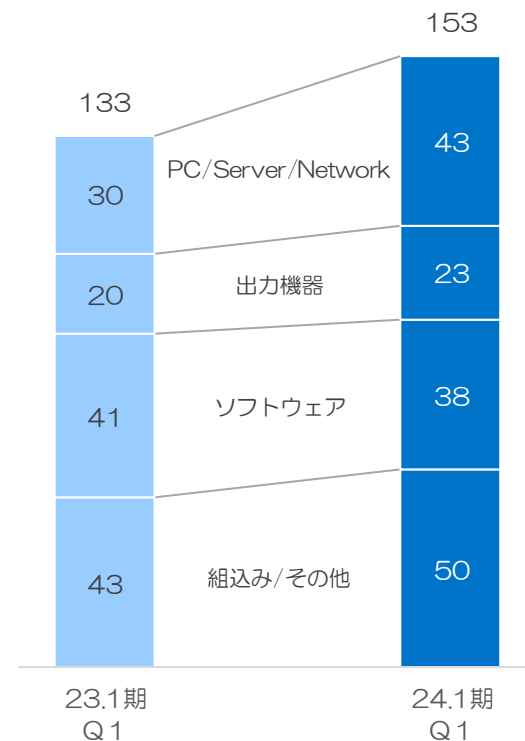
<品目別>

<用途別>



ICT・ソリューション

<品目別>



2024年1月期 通期の計画

◎ Q1着地および足元の事業動向等を踏まえ、売上高～営業利益見通しを修正。

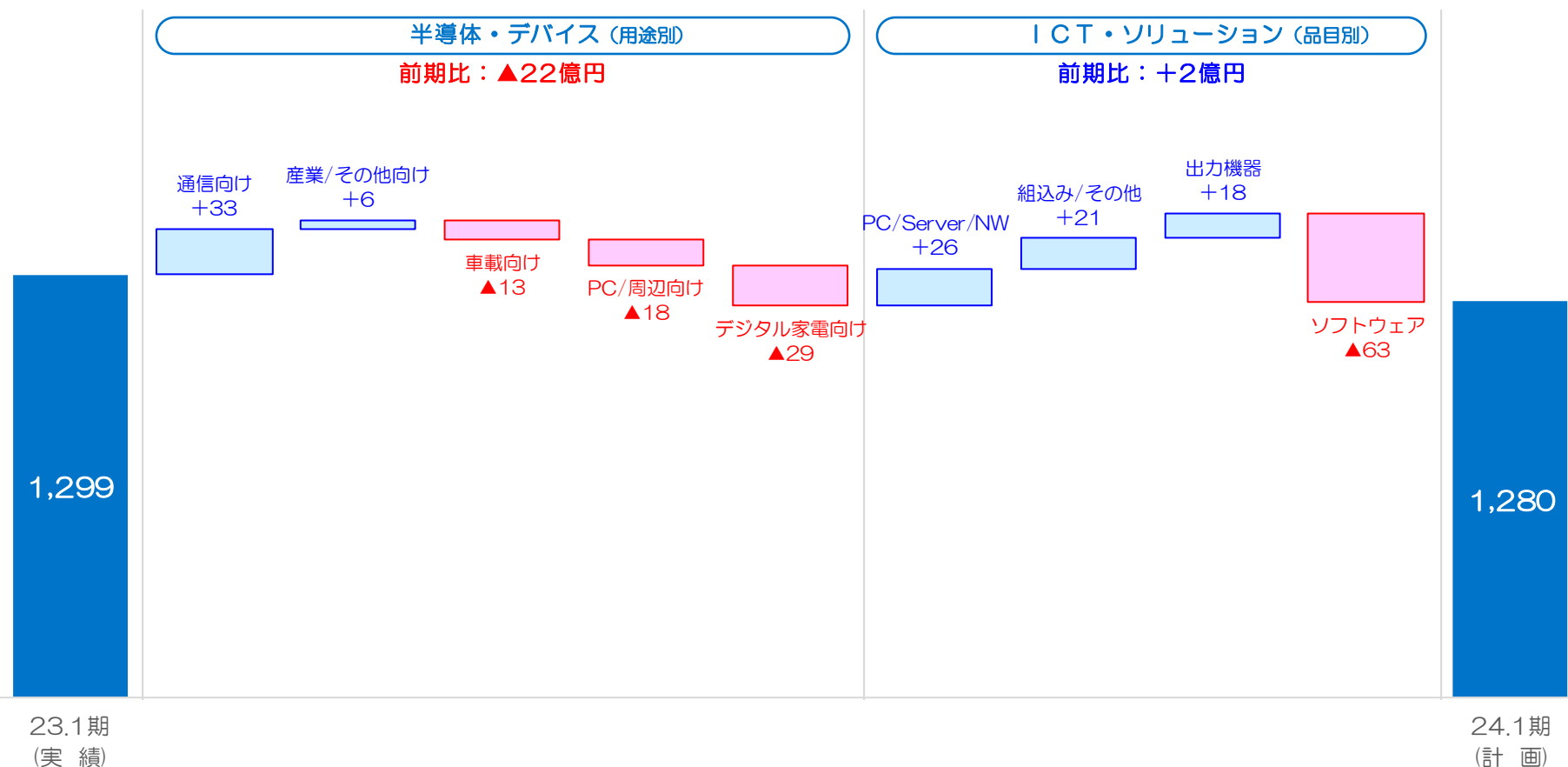
◎ リョーサン社の持分法適用関連会社化に伴う利益の計上は以下の通り反映。

	期初計画	修正計画	増減額
負ののれん発生益	31.0億円	42.1億円	+11.1億円
持分法投資損益	(織り込まず)	7.5億円	+7.5億円

◎ 親会社株主に帰属する当期純利益は、会社設立以来の最高益の見通し。

(単位：億円)	23.1期 実績	24.1期		対 前期		対 期初計画	
		修正計画	期初計画	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,299	1,280	1,200	▲19	▲1.5%	+80	+6.7%
売上総利益	135.8	136.5	128.0	+0.7	+0.5%	+8.5	+6.6%
(率)	10.5%	10.7%	10.7%				
販管費	88.9	93.5	92.0	+4.6	+5.2%	+1.5	+1.6%
営業利益	46.9	43.0	36.0	▲3.9	▲8.4%	+7.0	+19.4%
(率)	3.6%	3.4%	3.0%				
経常利益	44.8	89.0	65.0	+44.2	+98.8%	+24.0	+36.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	30.6	75.0	55.0	+44.4	+145.4%	+20.0	+36.4%
ROE	7.0%	15.4%	12.1%				

- ◎ 半導体・デバイスは、モバイル端末向け案件の立ち上がりが寄与するものの、前期の好市況の反動やテレビ向けの減少が響く。
- ◎ ICT・ソリューションは、大口案件の終息によるソフトウェアの減少を、堅調なその他の品目の増加でカバーし、前期比増収を見込む。



<補 足> 品目別の状況

半導体・デバイス

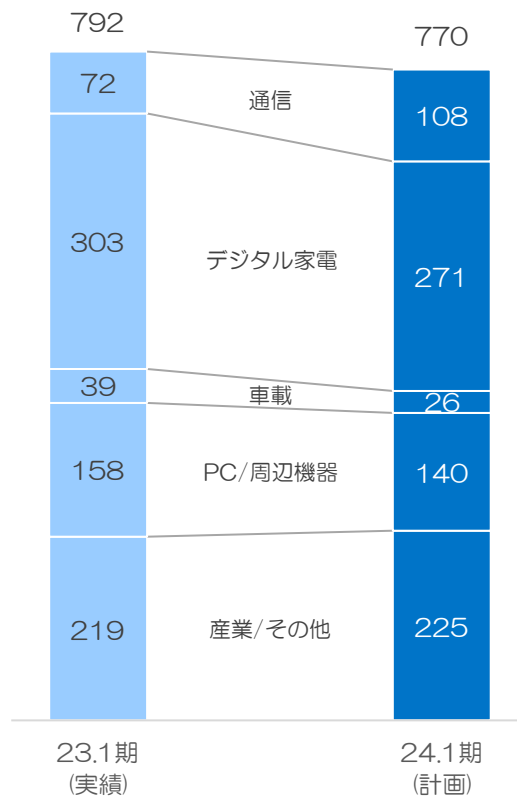
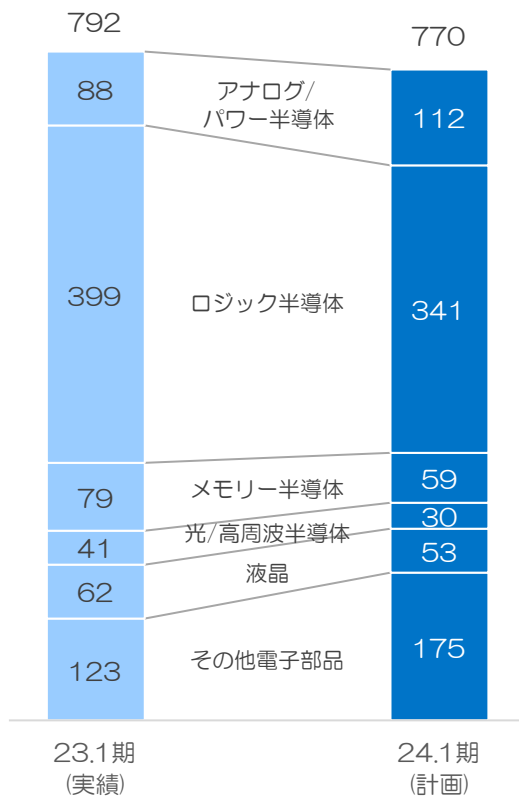
ICT・ソリューション

24.1期 (計画)	770 (60.2%)	510 (39.8%)	1,280
	▲2.7%	+0.5%	
23.1期 (実績)	792 (60.9%)	508 (39.1%)	1,299

半導体・デバイス

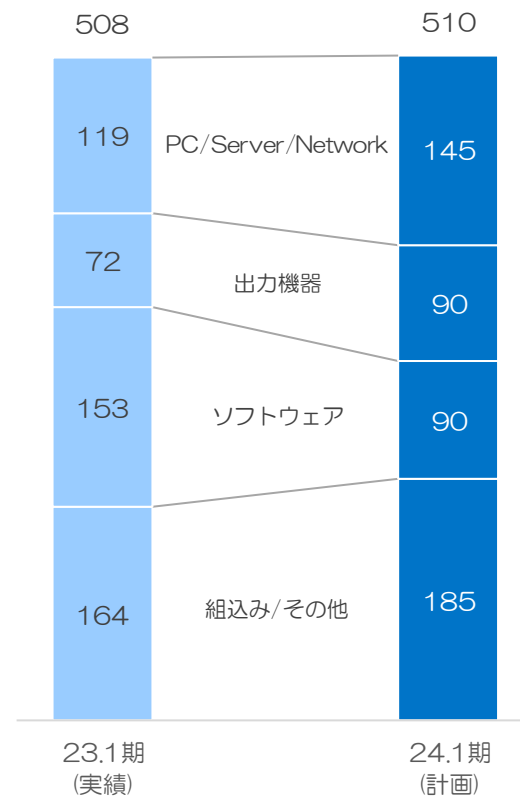
<品目別>

<用途別>



ICT・ソリューション

<品目別>



◎ 還元の基本方針：DOE（純資産配当率）5%を目安とした配当の実施。

⇒ 親会社株主に帰属する当期純利益が過去最高益となる業績見通しを踏まえ、1株当たり配当の計画を120⇒160円に引き上げ（前期比+50円）。

		1株当たり配当金		
		Q2末	期 末	年 間
24.1期	（修正計画）	80円	80円	160円
	（期初計画）	60円	60円	120円
23.1期	（実績）	50円	60円	110円

 40円増配
 10円増配

【「業績予想」および「配当予想」に基づく各指標の見込み】

		ROE	配当性向	DOE
24.1期	（修正計画）	15.4%	43.1%	6.6%
	（期初計画）	12.1%	44.1%	5.2%
23.1期	（実績）	7.0%	72.6%	5.1%

● 注意事項

本資料内の業績および将来に対する見通しは、
当社が発表時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の結果は経済環境やその他の様々な要因により、
当初の見通しとは異なる可能性がありますことを予めご承知おきください。

— 本資料に関するお問い合わせ先 —

菱洋エレクトロ株式会社

企画本部 広報部

TEL : 03 (3546) 6331 E-mail : irmanager@ryoyo.co.jp

RYOYO

すべてを、つなげよう。技術で、発想で。